

MEIKO
REPORT第51期
株主通信

(2025年4月1日から2026年3月31日)

証券コード：6787

株式会社 メイコー

財務ハイライト

売上高

240,574 百万円

営業利益

24,572 百万円

親会社株主に帰属する当期純利益

19,782 百万円

連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前期末 2025年3月31日現在	当期末 2026年3月31日現在
資産の部		
流動資産	114,112	142,528
固定資産	142,253	192,763
有形固定資産	129,570	174,893
無形固定資産	5,696	5,029
投資その他の資産	6,986	12,840
資産合計	256,366	335,291
負債の部		
流動負債	100,257	128,294
固定負債	40,502	63,189
負債合計	140,760	191,484
純資産の部		
株主資本	81,691	98,765
資本金	12,888	12,888
資本剰余金	13,820	13,820
利益剰余金	57,649	74,698
自己株式	△2,666	△2,641
その他の包括利益累計額	26,547	37,502
その他有価証券評価差額金	92	△127
繰延ヘッジ損益	50	△57
為替換算調整勘定	26,322	37,514
退職給付に係る調整累計額	82	172
純資産合計	115,605	143,807
負債純資産合計	256,366	335,291

連結損益計算書

(単位：百万円)

	前期(累計) 2024年4月1日～ 2025年3月31日	当期(累計) 2025年4月1日～ 2026年3月31日
売上高	206,806	240,574
売上原価	167,030	190,144
売上総利益	39,775	50,430
販売費及び一般管理費	20,692	25,857
営業利益	19,083	24,572
営業外収益	1,890	4,449
営業外費用	2,210	2,534
経常利益	18,763	26,488
特別利益	172	1,575
特別損失	391	653
税金等調整前当期純利益	18,544	27,410
法人税等	3,448	7,457
当期純利益	15,096	19,953
非支配株主に帰属する当期純利益 又は当期純損失(△)	171	171
親会社株主に帰属する当期純利益	14,924	19,782

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前期(累計) 2024年4月1日～ 2025年3月31日	当期(累計) 2025年4月1日～ 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,655	27,534
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,327	△55,483
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,141	30,080
現金及び現金同等物に係る換算差額	△373	1,422
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,095	3,554
現金及び現金同等物の期首残高	21,363	22,913
連結の範囲の変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額(△は減少)	453	-
現金及び現金同等物の期末残高	22,913	26,467

財務のポイント

●連結貸借対照表

- ・当期連結会計期間末の総資産は335,291百万円となり、前連結会計年度末比78,925百万円増加
- ・その主な要因は、流動資産において、現金及び預金が4,353百万円増加、売掛金が14,081百万円増加、棚卸資産が11,042百万円増加、固定資産において、有形固定資産が45,322百万円増加、投資有価証券が4,654百万円増加。
- ・当連結会計年度末の負債は、191,484百万円となり、前連結会計年度末に比べ50,723百万円増加。

- ・その主な要因は、流動負債において、支払手形及び買掛金が9,437百万円増加、短期借入金が2,610百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が8,992百万円増加、未払法人税等が3,838百万円増加、流動負債のその他が2,600百万円増加、固定負債において、長期借入金が22,942百万円増加。
- ・当連結会計年度末の純資産は、143,807百万円となり、前連結会計年度末に比べ28,2017百万円増加。
- ・その主な要因は利益剰余金が17,048百万円増加、為替換算調整勘定が11,192百万円増加。



株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2025年度の業績についてご報告申し上げます。

代表取締役社長 **名屋 佑一郎**

業績報告

2025年度連結実績および今期予想

(単位：億円)

	2024年度		2025年度		2026年度	
	通期実績	利益率	通期予想	利益率	通期予想	利益率
売上高	電子回路基板	1,706	1,980	2,540		
	電子機器	362	426	660		
	合計	2,068	2,406	3,200		
営業利益	電子回路基板	172	212	334	13.1%	
	電子機器	19	34	46	7.0%	
	合計	191	246	380	11.9%	
	経常利益	188	265	350	10.9%	
	当期純利益	149	198	270	8.4%	
期中平均為替レート (JPY/USD)	152.57	151.06	150			

商品別・仕様別売上および今期予想

(単位：億円)

	2024年度	2025年度	2026年度		2024年度	2025年度	2026年度
	通期実績	通期実績	通期予想		通期実績	通期実績	通期予想
車載	904	975	1,000	4層板以下	423	455	450
スマホ・タブレット	225	294	370	16層板以下	333	365	400
衛星通信	165	282	550	多層貫通基板	756	820	850
半導体PKG基板	10	20	30	8層板以下	509	615	870
モジュール基板	92	92	130	16層板以下	378	483	600
AIサーバー	42	73	170	高多層			90
リジッドフレキ、フレキ、放熱、大電流、その他	268	244	290	ビルドアップ基板	887	1,098	1,560
電子回路基板	1,706	1,980	2,540	半導体PKG基板	10	20	30
EMS	185	197	250	電子回路基板	1,706	1,980	2,540
ODM	177	229	310	EMS	185	197	250
コンポーネント			100	ODM	177	229	310
電子機器	362	426	660	コンポーネント			100
合計	2,068	2,406	3,200	電子機器	362	426	660
				合計	2,068	2,406	3,200

2025年度業績について

当連結会計年度における電子部品業界は、AIサーバーをはじめとするデータセンター関連分野では引き続き需要が拡大しました。自動車分野では自動車メーカー各社のEV戦略の見直しが進められたものの、自動運転や運転支援などの需要は堅調に推移しています。一方で、中東情勢の緊迫化や地政学的な緊張、貿易政策の変更など依然として先行きが不透明な状況が続いております。

このような環境の下、当社グループでは、売上高、利益ともに過去最高を更新しました。車載向け基板は、新規客への販売が増加しました。スマートフォン・タブレット向け基板は、ハイエンドモデル向け基板が増加し堅調に推移しました。情報通信向け基板は、衛星通信向けが大きく増加しました。モジュール基板は、SSD、通信モジュールが好調に推移しました。電子機器事業は受託開発案件を中心に堅調に推移しました。利益面では、資源価格高騰の影響を受けましたが、付加価値の高いビルドアップ基板が大幅に増加したことや工場稼働率の向上、生産性改善により好調に推移しました。

2026年度業績予想について

次期の当社グループの業績の見通しは、これまで積極的な投資を進めてきたベトナム第4工場とホアビン工場での生産開始を業績予想に織り込みました。商品別売上では、車載向け基板は自動運転や運転支援案件の受注が拡大する見通しです。スマートフォン・タブレット向け基板は新規顧客向けにホアビン工場での生産を開始いたします。ベトナム第4工場では、衛星通信およびAIサーバー向け基板の生産を拡大してまいります。損益面では引き続き、工場の自動化・省人化、歩留まり改善など生産性の改善を推進し、さらなる収益性の強化を図ってまいります。

中期経営計画の概要

経営目標 (2028年度)	単位：億円
売上高	4,600
営業利益	650
経常利益	625
純利益	470
設備投資累計	1,900

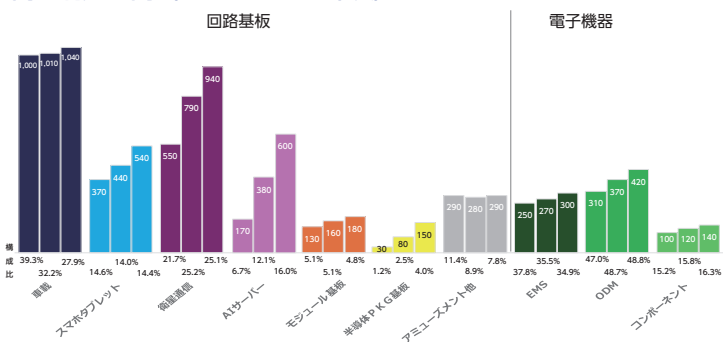
	2025年度 (実績)	2026年度 (予想)	2027年度 (予想)	2028年度 (予想)	年平均成長率 (2025-2028)
売上高合計	2,406	3,200	3,900	4,600	24.1%
営業利益	246	380	510	650	38.2%
営業利益率 (%)	10.2	12	13	14	
経常利益	265	350	485	625	33.1%
当期純利益	198	270	365	470	33.4%
投資額	497	700	700	700	
研究開発費	60	80	100	115	
EBITDA	368	554	858	1,070	
総資産合計	3,353	4,175	4,818	5,453	
純資産合計	1,438	1,663	1,820	2,219	
有利子負債残高	1,219	1,785	2,114	2,193	
自己資本比率 (%)	40.7	38.2	36.3	39.4	
D/Eレシオ	0.85	1.07	1.16	0.99	
ROE (%)	14.6	17.1	20.1	21.1	
ROIC (%)	7.7	9.6	10.5	11.8	
1株当たり純利益 (円)	744	1,040	1,362	1,749	
1株当たり配当額 (円)	115	160	200	260	
配当性向 (%)	15	15	15	15	
DOE (%)	2.1	2.6	2.9	3.1	
ドル円為替レート	150円	150円	150円	150円	

中期経営計画の概要

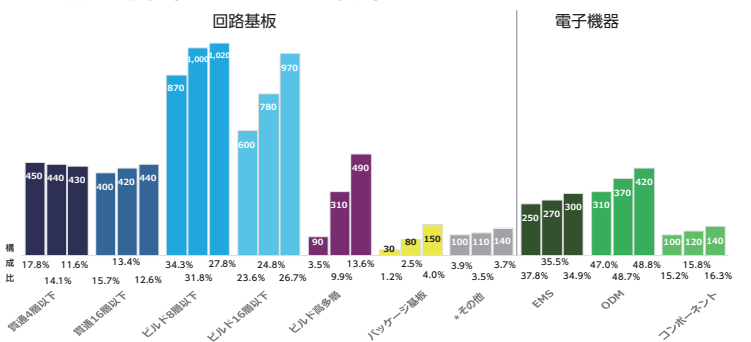
衛星通信およびAIサーバー向け基板の受注が拡大している状況を踏まえて、2028年度を最終年度とする中期経営計画を策定いたしました。設備投資累計で1,900億円を計画しており、売上高の年平均成長率を24%、営業利益では38%の成長に取り組んでまいります。

計画の概要としては、基板回路事業では車載向け基板が緩やかな成長にとどまるものの、スマートフォン、衛星通信、AIサーバー向け基板の需要の高まりを受け投資を進めておりました。ベトナム第4工場では量産を開始し、ホアビン工場においても今期より量産を開始いたします。さらに需要拡大傾向が継続する見通しであることから、ホアビン第2工場、クアンミン第3工場とイエンクアン工場の建設などの投資を進めてまいります。半導体パッケージ基板は、半導体市場の悪化で当初計画に対して遅延が生じておりますが、市場の回復に合わせた工場黒字化に取り組んでまいります。電子機器事業においては、受託開発事業を強化することを目的としたM&Aを行いました。今後グローバルのワンストップサービスを加速することで、事業の拡大を図ってまいります。

商品別売上高 (2026~2028年度)



製品別売上高 (2026~2028年度)



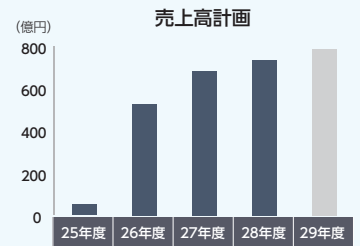
*その他は、リジッドフレキ、フレキ、放熱、大電流、その他基板

新工場の状況

●ベトナム第4工場 投資額を250億円から450億円に引き上げ。衛星、AIサーバー向け基板を製造

ベトナム第4工場 事業概要

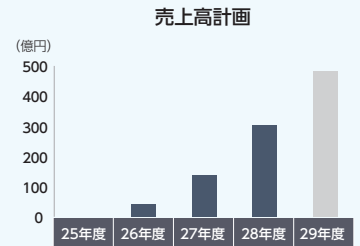
延床面積	約60,000㎡(15,000㎡×4F)
投資規模	約250億円→約450億円
事業内容	第2工場(PCB)のキャパ補完 衛星・AI向け高多層ビルドアップ基板 メモリーモジュール基板



●ホアビン工場 下期より生産を開始し、27年度に本格的生産を開始する予定

ホアビン工場 事業概要

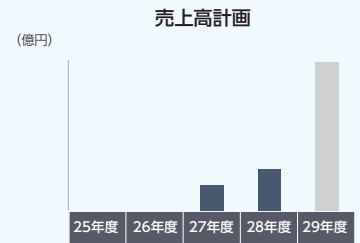
所在地	ベトナム フート省 (旧ホアビン省)
敷地面積	約93,000㎡
延床面積	約60,000㎡(第1工場)
投資規模	約500億円(第1工場)
事業内容	高周波・高密度ビルドアップ基板(SLP)



●ACCL社とのJV進捗状況 新規にAIサーバーマザーボード基板分野に参入

ACCL社とのJV会社概要

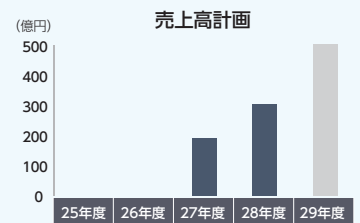
企業名	Allied Circuit Meiko Vietnam Co.,Ltd.
出資比率	ACCL70%、Meiko30%
場所	ベトナム フート省(旧ホアビン省)
延床面積	約60,000㎡(第2工場)
事業内容	AIサーバー向け高多層基板



●クアンミン第3工場 ベトナムPCB事業の需要増対応によるキャパ増設ならびに今後の薄型ハイエンドスマホ対応

クアンミン第3工場 事業概要

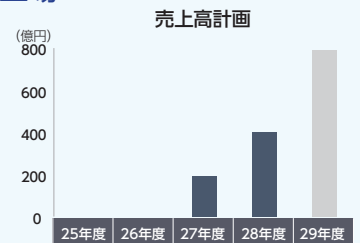
所在地	ベトナム ハノイ市 Quang Minh工業団地
敷地面積	約63,000㎡
延床面積	約53,000㎡(第3工場)
投資規模	約400億円
事業内容	最先端高密度ビルドアップ基板



●イエンクアン工場 衛星を中心とした超高生産性中高多層ビルドアップ自動化工場

イエンクアン工場 事業概要

所在地	ベトナム フート省 Amber Yen Quan工業団地
敷地面積	約110,000㎡
延床面積	約100,000㎡(第1工場:20,000㎡×5F)
投資規模	約600億円
事業内容	衛星向け中高多層ビルドアップ基板



●電子機器M&Aについて

M&Aの狙い:受託設計開発ビジネスの強化

1. 約150名のエンジニア獲得による開発力強化
2. 無線通信・センサー等の先端ハード・ソフトウェア技術の取得
3. 両社顧客基盤の融合によるクロスセル拡大と成長加速



飯山本社工場



須坂技術開発センター

株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーのご支援、ご期待にお応えするべく、改善のための各々の施策に全力で取り組み、業績と企業価値の向上に努めてまいります。今後とも一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



取締役常務執行役員
桔梗 芳人

2025年度は売上高2,406億、営業利益246億と売上/利益共過去最高の業績となりました。改めてこれは株主の皆様への絶大なご支援の賜物と感謝を申し上げる次第でございます。

2025年度を振り返りますと大変厳しい年でした。国際情勢の不安定化、通商政策の変化、物流ルートの変動、原材料高騰、半導体等電子部品供給不足等々従来以上に複雑化した状況でした。その厳しい環境の中で当社は長年のプリント基板の開発・製造で培ってきた高度な技術力と知見を基盤に、国内外での果敢な営業推進により先進的なお客様より評価を頂き、スマートフォン、衛星通信分野、AI機器、産業機器そして車載分野等においてビジネスの幅が広がりました。その背景には国内外での積極的な投資があり、この非常に好循環の経営が過去最高の業績を計上出来たものと考えております。

この良い流れは今期2026年度も続き、ベトナムハノイ地域でのさらなる工場設立も計画されております。メイコーでは世界中で巻き起こる技術革新への高度なプリント基板提供を軸にそれに伴う回路設計や実装技術などの電子分野のソリューション事業も加わり、電子事業ビジネス分野で既に他社にない競争力を有しております。そして更なる発展に向けて積極果敢なビジネスを進めてまいり所存でございます。

今期も引き続き売上/営業利益共に過去最高を超えるべく全社員一丸となり、グローバルで技術革新、社会に貢献していく魅力たっぷりの企業に成長させていきたいと考えております。

株主の皆様におかれましては引き続きご支援ご鞭撻を賜りますよう切にお願い申し上げます。

コーポレートデータ (2026年3月31日現在)

会社概要

商号	株式会社メイコー
設立	1975年11月25日
資本金	12,888百万円
従業員数	14,332名(連結) (国内1,416名・海外12,916名)
主な事業内容	電子回路基板等の設計、製造および販売ならびにこれらの付随業務に関する電子関連事業

役員

代表取締役社長執行役員	名屋 佑一郎
代表取締役副社長執行役員	坂手 敦
取締役専務執行役員	和田 純也
取締役常務執行役員	桔梗 芳人
取締役常務執行役員	名屋 茂
取締役	土屋 奈生
取締役	西山 洋介
取締役	原田 隆
取締役	小林 俊文
常勤監査役	松田 孝広
監査役	江尻 琴美
監査役	橋本 真一

関連会社

株式会社山形メイコー	電子関連事業
株式会社宮城メイコー	電子関連事業
株式会社メイコーテック	電子関連事業
株式会社メイコーテクノ	電子関連事業
メイコーエレクトロニクス株式会社	電子関連事業
メイコーエレクトロニクスファクトリー株式会社	電子関連事業
名幸電子香港有限公司	電子関連事業
名幸電子(広州南沙)有限公司	電子関連事業
名幸電子(武漢)有限公司	電子関連事業
広州市斯皮德貿易有限公司	電子関連事業
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Hoa Binh Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Hai Duong Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics America, Inc.	電子関連事業

株式情報

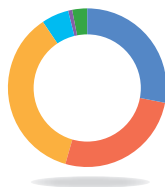
発行可能株式総数	普通株式	70,000,000株
	第一回社債型種類株式	100株
発行済株式の総数	普通株式	26,000,612株
	(自己株式 802,708株を除く)	
	第一回社債型種類株式	70株
株主数	普通株式	4,105名
	第一回社債型種類株式	1名

大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
名屋 佑一郎	4,704	18.09
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3,106	11.95
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	1,837	7.07
CLEARSTREAM BANKING S.A.	976	3.75
MSIP CLIENT SECURITIES	830	3.19
名幸興産株式会社	608	2.34
HSBC-FUND SERVICES HSBC - 006 MF EFM	570	2.19
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505329	556	2.14
JP JPMISE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO	542	2.09
有限会社ユーホー	521	2.00

※当社は、自己株式802,708株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別株式分布状況



個人・その他	28.06%
金融機関	26.50%
外国法人等	36.08%
その他の法人	5.62%
金融商品取引業者	0.75%
自己名義	2.99%

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(郵便物送付先)	〒168-0063 東京都杉並区泉東二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎ 0120-782-031
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場
公告の方法	電子公告により当社ウェブサイトに掲載 https://www.meiko-elec.com/ir/pa.shtml ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載

株式に関するお問合せ

- 住所変更、配当金受取り方法の変更等のお手続きは、お取引の証券会社にお問合せください。
- 証券会社の口座をご利用でない株主様、未払配当金のお手続きは、上記三井住友信託銀行証券代行部にお問合せください。